



新聞稿共2頁，敬請惠予刊登  
2008年5月8日

## 茂德科技與海力士簽署策略聯盟合約

(2008年5月8日，新竹與首爾)茂德科技(股票代號:5387)今(8)日宣布與韓國海力士半導體 (Hynix Semiconductor) 共同簽署策略聯盟合約，除了強化雙方在先進DRAM製程技術的合作外，海力士半導體將投資入股茂德科技。此項簽署的策略聯盟合約，延伸既有的技術夥伴關係，更進一步擴展至股東關係。

依據雙方簽署的策略聯盟合約，韓國海力士半導體將技術移轉50奈米世代堆疊式DRAM製程技術給茂德，同時茂德將提供其十二吋晶圓廠生產該項製程技術的DRAM產品給海力士半導體。海力士半導體並預計於近日時程內向韓國政府提出申請，以確保其技術夥伴於50奈米世代堆疊式DRAM製程技術的領先優勢地位。

此外，海力士半導體規劃與特定投資人合作透過私募方式，取得茂德百分之八至百分之十的股份，以資金挹注入股投資的方式，鞏固雙方未來的長期策略聯盟合作關係。

茂德科技董事長暨總經理陳民良表示，海力士半導體在全球DRAM產業中是備受肯定的前瞻技術領導者，其50奈米世代堆疊式DRAM製程技術之進展時程居全球DRAM領導廠商之一。今天茂德科技與海力士半導體的聯盟，是擴展由技術夥伴進而成為主要股東之一親上加親緊密的聯盟，是同時為雙方公司與客戶的雙贏合作案。

### 關於韓國海力士半導體 (Hynix Semiconductor)

韓國海力士半導體是全球頂尖的半導體領導廠商，產品包括動態隨機存取記憶體 (DRAM) 與快閃記憶體等。該公司為韓國上市公司，其全球存託憑證亦於盧森堡證券股票市場上市。欲了解更多資訊，請瀏覽企業網站：[www.hynix.com](http://www.hynix.com)。

### 關於茂德科技

茂德科技總部位於台灣新竹科學工業園區，為一全方位記憶體解決方案領導廠商，在全球DRAM產業以先進的製程技術與優異的生產效率著稱。產品以高容量與高效能的標準型動態隨機記憶體(DRAM)為主，並生產其他記憶體產品，包括pseudo-SRAM和低功率SDRAM。茂德科技於中華民國證券櫃檯買賣中心公開發行股票。如需更多資訊，請瀏覽企業網站：[www.promos.com.tw](http://www.promos.com.tw)。

## **Press Contacts—Hynix Semiconductor**

Corporate Communication Team

Manager

Hyun Park

Phone: +82-2-3459-5353

Fax: +82-2-3459-5333

e-Mail: hyun.park@hynix.com

Assistant Manager

Seong-Ae Park

Phone: +82-2-3459-5325

Fax: +82-2-3459-5333

e-Mail: seongae.park@hynix.com

## **新聞聯絡—茂德科技**

ProMOS Technologies 茂德科技

發言人暨行銷業務本部副總經理 曾邦助博士

電話：(03) 566-3196

Mobile: 0972-238-861

E-mail: ben\_tseng@promos.com.tw

ProMOS Technologies 茂德科技

公共關係部: 翁慧珊

電話：(03) 566-3449

PHS: 0966-212-623

E-mail: sophia\_wong@promos.com.tw

This document contains “forward-looking statements” within the meaning of Section 27A of the United States Securities Act of 1933 and Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934. You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which apply only as of the date of this document. The events mentioned in these forward-looking statements may occur in a different manner or at different times than those given in the forward-looking statement or not at all.

Such occurrence or nonoccurrence and our results of operations, financial conditions or business prospects implied thereby may differ materially from those expressed or implied in these forward looking statements for a variety reasons, including risks associated with the timely delivery and installations of equipment and machinery, malfunction of equipment or machinery, cyclicalities and market conditions in the DRAM industry, demand for DRAMs, competition in our industry and other factors.